

2023年7月期第3四半期 決算概要

サムコ株式会社

証券コード: 6387 東証プライム

23/7月期第3Qの実績

(2022.8.1 ~ 2023.4.30)

23/7月期第3四半期 業績

□ 売上高 55.7億円(前年同期比+30.7%)

□ 営業利益 13.1億円(前年同期比+73.1%)

- 営業利益率23.6%。

□ 受注高 63.7億円(前年同期比+12.0%)

- 受注残高58.2億円。(前年同期比+30.9%)

23/7月期第3Q 実績報告

(単位: 百万円)

		22/7月期3Q 実績	23/7月期3Q 実績	前年同期比
売上高	Net Sales	4,268	5,576	30.7 %
売上総利益	Gross Profit	2,082	2,791	34.0 %
売上高総利益率	Gross Profit Ratio	48.8 %	50.1 %	—
営業利益	Operating Profit	759	1,314	73.1 %
営業利益率	Operating Profit Ratio	17.8 %	23.6 %	—
経常利益	Ordinary Profit	839	1,349	60.7 %
当期純利益	Net Income	584	966	65.5 %

- 原材料価格の上昇はあるものの、原価低減や操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持。

23/7月期第3Q 装置別売上高

(単位: 百万円)

	22/7月期3Q		23/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
CVD装置	815	19.1 %	1,000	22.6 %	17.9 %
エッチング装置	1,752	41.1 %	2,631	50.1 %	47.2 %
洗浄装置	312	7.3 %	569	82.1 %	10.2 %
部品・メンテナンス	1,387	32.5 %	1,376	△0.8 %	24.7 %
合計	4,268	100.0%	5,576	30.7 %	100.0 %

【CVD装置】 オプトエレクトロニクス分野のLD向け、電子部品分野の高周波デバイス向け等の販売。

【エッチング装置】 オプトエレクトロニクス分野のLD向け、電子部品分野の高周波デバイス向け等の販売。

【洗浄装置】 実装・表面処理分野の各種表面改質用途など幅広い分野への販売。

23/7月期第3Q 分野別売上高

(単位: 百万円)

	22/7月期3Q		23/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
オプトエレクトロニクス分野	729	17.1 %	1,198	64.4 %	21.5 %
電子部品・MEMS分野	1,247	29.3 %	1,516	21.6 %	27.2 %
シリコン分野	551	12.9 %	301	△ 45.3 %	5.4 %
実装・表面処理分野	39	0.9 %	226	467.9 %	4.1 %
表示デバイス分野	69	1.6 %	46	△ 33.0 %	0.8 %
その他分野	243	5.7 %	910	274.0 %	16.3 %
部品・メンテナンス	1,387	32.5 %	1,376	△ 0.8 %	24.7 %
合計	4,268	100.0 %	5,576	30.7 %	100.0 %

【オプトエレクトロニクス分野】 LD、マイクロLED、光導波路、光センサー向け。

【電子部品・MEMS分野】 高周波フィルタ・高周波デバイス、量子デバイス、パワーデバイス向け。

23/7月期第3Q 用途別売上高

(単位: 百万円)

	22/7月期3Q		23/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
生産用	1,193	28.0 %	2,282	91.2 %	40.9 %
研究開発用	1,687	39.5 %	1,918	13.7 %	34.4 %
部品・メンテナンス	1,387	32.5 %	1,376	△ 0.8 %	24.7 %
合計	4,268	100.0%	5,576	30.7 %	100.0 %

【生産用】 LD、光センサ、高周波デバイス・フィルタ、欠陥解析向けが好調で、大きく販売を伸ばした。

【研究開発用】 LD、量子デバイス、高周波デバイス、パワーデバイス、バイオセンサ向け、共用設備への販売。

23/7月期第3Q 地域別売上高

(単位: 百万円)

	22/7月期3Q		23/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
(国内)	3,002	70.3 %	3,550	18.2 %	63.7 %
(海外合計)	1,265	29.7 %	2,026	60.1 %	36.3 %
アジア	999	23.4 %	1,564	56.6 %	28.1 %
北米	182	4.3 %	397	118.1 %	7.1 %
欧州	51	1.2 %	63	25.0 %	1.1 %
その他	33	0.8 %	—	—	—
合計	4,268	100.0 %	5,576	30.7 %	100.0 %

- 海外売上高比率 36.3%(通期計画は42.0%)。
- アジア市場: 中国885百万円、韓国355百万円、以下 台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドほか。
- 北米市場: コロナ後の落ち込みから挽回。

受注環境（受注高、受注残高）の変化



参考資料

会社概要

商 号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代 表 者	代表取締役会長 兼 CEO 辻 理(つじ おさむ) 代表取締役社長 兼 COO 川邊 史(かわべ つかさ)
設 立	1979年(昭和54年)9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売 上 高	64億187万円(2022年7月期)
従 業 員	177名(2023年4月)
証 券 コード	6387(東京証券取引所 プライム市場)



左:川邊 史、右:辻 理



最新の会社案内は[こちら](#)



当社のビジネスモデルは[こちら](#)

沿革(創業～2010年)

1979年9月	半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
1980年7月	半導体プロセス用大型CVD(Chemical Vapor Deposition)装置の開発、販売を開始
1984年7月	東京都品川区に東京出張所(現東日本営業部)を開設
1987年2月	米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設
1997年11月	麒麟ビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)膜を形成する技術を開発
2001年5月	日本証券業協会に株式を店頭上場
2004年12月	株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ 株式会社へ社名を変更
2010年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(2013年7月より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場



沿革の詳細は[こちら](#)

沿革(2011年～現在)

2013年7月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から市場第二部へ市場変更
2014年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
2014年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化(samco-ucp AGに社名変更)
2016年9月	Aqua Plasmaを用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始
2020年7月	第二生産技術棟内にCVD装置のデモルームを開設
2021年12月	電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH TM 」の販売を開始
2022年3月	第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ
2022年4月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行



沿革の詳細は[こちら](#)

国内拠点、海外拠点



京都地区



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



海外営業・サービス拠点(計11拠点)

海外売上高比率35.4%(2022年7月期実績)

現地の営業・サービス人員を強化し、海外市場の開拓を図る。

⇒インド・ベンガルールオフィスを開設(2022年7月)

各事業拠点の詳細は[こちら](#)

製品ラインナップ



deposition

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

■ドライエッチング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface
treatment

■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

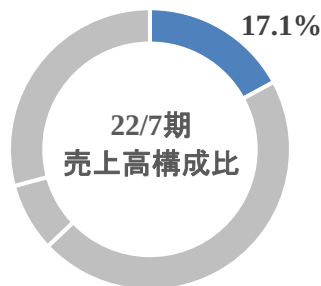


品目別売上高 CVD装置



装置ラインナップ

- ・ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置



概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source)-CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能であります。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD=Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能であります。

第43期有価証券報告書(2022.10.25提出)より



CVD装置の詳細は[こちら](#)



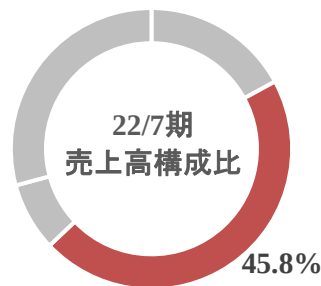
CVD装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 エッチング装置



装置ラインナップ

- ・ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ・シリコン深掘り装置
- ・RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- ・XeF₂ドライエッチング装置



概 要

各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP (Inductively Coupled Plasma=高密度プラズマ)を利用するエッチング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能です。

第43期有価証券報告書(2022.10.25提出)より



エッチング装置の詳細は[こちら](#)



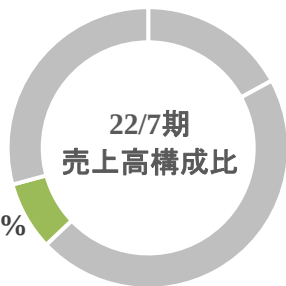
エッチング装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 洗浄装置



装置ラインナップ

- ・Aqua Plasma® クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー



概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウエット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能です。

2016年9月より販売を開始した水蒸気(H₂O)を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma(アクアプラズマ)洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能です。

第43期有価証券報告書(2022.10.25提出)より



洗浄装置の詳細は[こちら](#)



洗浄装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 部品・メンテナンス

主な内訳

- ・部品、消耗品
- ・修理、改造
- ・移設、作業
- ・メンテナンス

概要

当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

29.2%

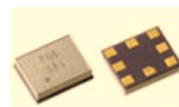
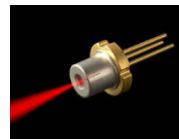
22/7期
売上高構成比



用途別売上高区分

用 途	概 要
オプトエレクトロニクス分野	主に化合物半導体から作られるLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)やマイクロLED、LD(Laser Diode=半導体レーザー)、面発光レーザー(VCSEL)などの発光デバイスのほか、電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりする光通信用デバイスなどに関する分野。
電子部品分野	パワーデバイス・高周波デバイス・各種センサー・MEMS(Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子)・SAW(Surface Acoustic Wave=弾性表面波)デバイス・量子デバイスなどに関する分野。
シリコン分野	三次元LSI(Large Scale Integrated circuit)・三次元パッケージやウェハー欠陥解析などに関する分野。
実装・表面処理分野	ICのパッケージングの洗浄や表面処理に関する分野であります。高密度実装に対応するために基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しており、高度な洗浄機能が要求されております。
表示デバイス分野	有機EL(Electro Luminescence)、LCD(Liquid Crystal Display=液晶表示素子)、VR(Virtual Reality)ディスプレイなどに関する分野。
その他分野	上記以外の分野。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する分野。

当社 第43期有価証券報告書(2022.10.25提出)より



当社製品が用いられるアプリケーション(例)



MEMS



TSV



SiCパワーデバイス



GaNパワーデバイス



LED

様々なアプリケーションの製造工程に
当社の製品が使用されています。



半導体レーザ(LD)



光導波路



フォトニック結晶



GaAs高周波デバイス



SAWデバイス

事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせることで、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD(半導体レーザー)	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga ₂ O ₃	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域(国)によって、売上高を以下の地域に区分しております。

地 域	対象となる国
日 本	日本国内
アジア	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド ほか
北 米	米国、カナダ、メキシコ
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ ほか
その他	オーストラリア、エジプト ほか

株式の状況（2023年1月末時点）

- ・発行可能株式総数 14,400,000株
- ・発行済株式の総数 8,042,881株
- ・株主数 6,798名
- ・大株主の状況

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,150,800	14.3
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	877,907	10.9
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	402,400	5.0
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	130,100	1.6
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	112,538	1.4
立田 利明	103,099	1.3

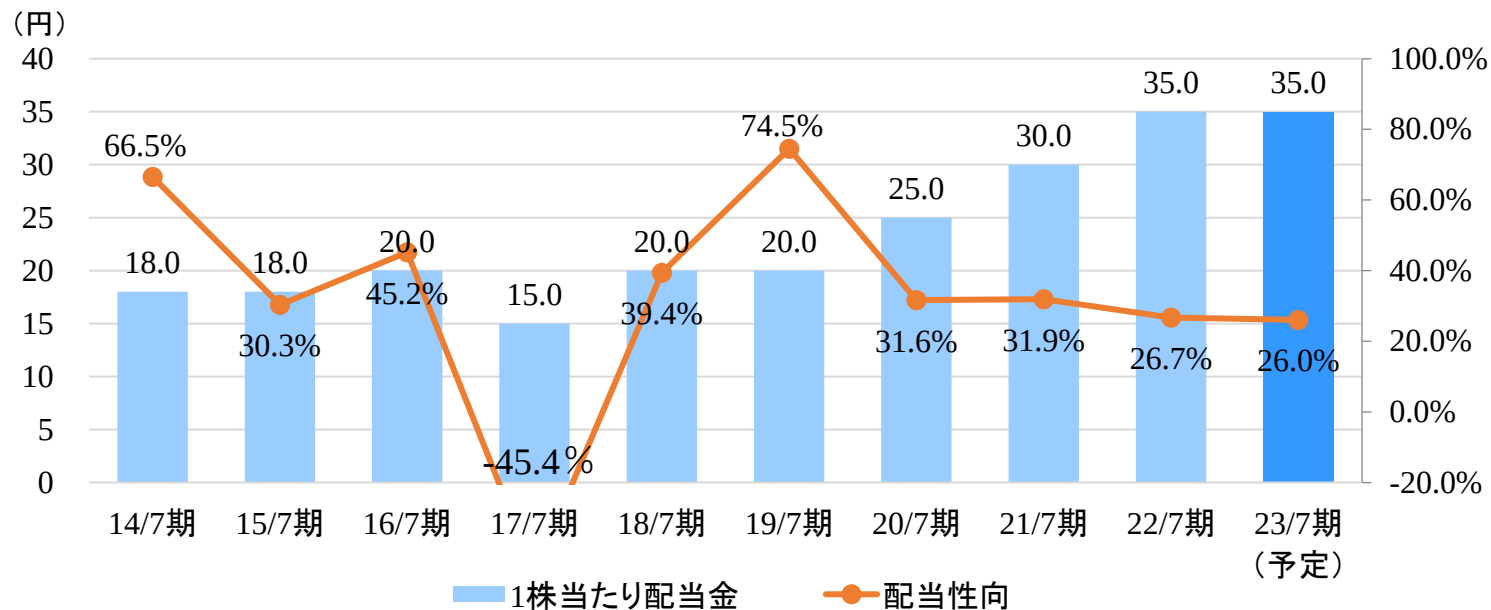
・所有者別株式分布状況(株式数ベース)



・所有者別株式分布状況(株主数ベース)



1株当たり配当金、配当性向 推移



経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、余剰資金については業績連動的な配当の考え方を合わせて取り入れております。

ESG・サステナビリティ



持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～

E 環境

《気候変動・脱炭素への取り組み》

- ・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。
- ・環境方針(2006年制定)に沿った取り組みを実施。

《環境配慮型製品》

- ・省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。
- ・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。
- ・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減

S 社会

《事業を通じた社会的価値の創造》

- ・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造

《社会貢献、地域貢献》

- ・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動
- ・京都工繊繊維大学への寄附講座
- ・従業員、会社からの寄付金活動。(日本赤十字社、京都大学ほか／ウクライナ支援、トンガ大津波支援)

G ガバナンス

《ガバナンス体制、ダイバーシティ》

- ・役員11名中、社外役員5名
- ・取締役会の実効性評価による改善、検討。
- ・議決権電子行使プラットフォームの利用。(2023年7月期末より対応予定)
- ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概 要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。

TCFD対応

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)



G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

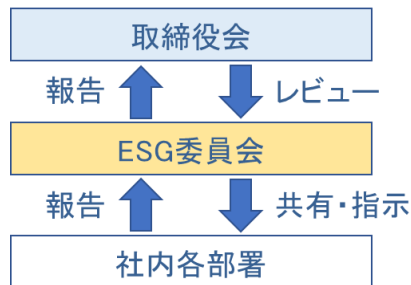
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役会に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

サムコとSDGsの関わり

- ・当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。



サムコのSDGsの取り組み例



 3 すべての人に健康と福祉を	・マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・深紫外LED空気清浄機(コロナウィルス不活性化)製造に当社装置が寄与。 ・医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・日本赤十字社への寄付。(ウクライナ支援、トンガ大津波支援等)
 4 質の高い教育をみんなに	・国内外の大学(ODA案件を含む)・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる研究者を支援。 ・京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
 6 安全な水とトイレを世界中に	・浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	・省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC(炭化シリコン)、GaN(窒化ガリウム)、酸化ガリウム(Ga_2O_3)等の加工に当社装置が寄与。 ・高効率LED素子、マイクロLEDや、LD(レーザー)の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
 8 働きがいも経済成長も	・当社はファブライツ企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

サムコのSDGsの取り組み例



	産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供 ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL(面発光レーザー)を含む通信用LD(レーザー)用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術(LiDAR)、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
	・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
	・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
	・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

23/7月期 トピックス（メディア掲載）

「これから伸びる京阪神のカイシャ2022秋」掲載

- ▶ 日刊工業新聞西日本支社様が発行される冊子「これから伸びる京阪神のカイシャ2022秋」に、“化合物半導体加工に強みを持つ装置メーカー—車の電動・自動運転化で広がる需要”として当社が紹介されました。
- ▶ 記事は[こちら](#)からご覧ください。



日本半導体製造装置協会（SEAJ）会報「会員便り」掲載

- ▶ 半導体及び液晶パネル製造装置関連企業を会員とする、全国団体 一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）の会報180号の「会員便り」に、当社の会社紹介が掲載されました。
- ▶ 記事は[こちら](#)からご覧ください。



23/7月期 トピックス（メディア掲載）

「KYOらしくKYOを生きよう。～働くまち京都～」掲載

- 京都市と東急不動産ホールディングスグループ株式会社と株式会社学生情報センターが、「KYOらしくKYOを生きよう。～働くまち京都～」をテーマに制作したデジタルブックに当社社員が紹介されました。
- 記事は[こちら](#)からご覧ください。



お問い合わせ

サムコ 株式会社

広報・IR室

E-mail : koho@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology